



Initial Product/Process Change Notification

Document #: IPCN22945X

Issue Date: 31 Oct 2019

Title of Change:	Qualification of TSOP6 Device NTGS3446T1G from 2.0 mils Au Wire to 2.0 mils Cu Wire.	
Proposed First Ship date:	15 Jul 2020 or earlier if approved by customer	
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Rafidah.MohdRasid@onsemi.com	
PCN Samples Contact:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <PCN.samples@onsemi.com>. Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.	
Type of Notification:	This is an Initial Product/Process Change Notification (IPCN) sent to customers. An IPCN is an advance notification about an upcoming change and contains general information regarding the change details and devices affected. It also contains the preliminary reliability qualification plan. The completed qualification and characterization data will be included in the Final Product/Process Change Notification (FPCN). This IPCN notification will be followed by a Final Product/Process Change Notification (FPCN) at least 90 days prior to implementation of the change. In case of questions, contact <PCN.Support@onsemi.com> The completed qualification and characterization data will be included in the Final Product/Process Change Notification (FPCN). This IPCN notification will be followed by a Final Product/Process Change Notification (FPCN) at least 90 days prior to implementation of the change. In case of questions, contact <PCN.Support@onsemi.com>	
Marking of Parts/ Traceability of Change:	Affected products will be identified with date code after WW29'20 onwards	
Change Category:	Assembly Change	
Change Sub-Category(s):	Material Change	
Sites Affected:		
ON Semiconductor Sites	External Foundry/Subcon Sites	
ON Semiconductor Seremban, Malaysia	None	
Description and Purpose:		
This IPCN is to announce the qualification of TSOP6 Device NTGS3446T1G from 2.0 mils Au Wire to 2.0 mils Cu Wire.		
Table below shows the comparison:		
	Before Change Description	After Change Description
Bond Wire	2.0mil Gold Wire	2.0mil Cu Wire
There is no product marking change as a result of this change.		

**Qualification Plan:**

QV DEVICE NAME: NTGS3446T1G

PACKAGE: TSOP 6

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	2016 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc
HAST*	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
H3TRB*	JESD22-A101	85°C, 85% RH, bias	2016 hrs
UHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	

Estimated date for qualification completion: 26 March 2020

List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the **PCN Customized Portal**.

Part Number	Qualification Vehicle
NTGS3446T1G	NTGS3446T1G

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: *The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号 : IPCN22945X

発行日 : 31 Oct 2019

変更件名:	TSOP6 製品 NTGS3446T1G における 2.0 mils Au ワイヤーから 2.0 mils Cu ワイヤーへの変更認定。	
初回出荷予定日:	15 Jul 2020 またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <AnneLee.Lim@onsemi.com> にお問い合わせください。	
サンプル:	<p>サンプルは認定完了後に提供が可能となります。</p> <p>現地のオン・セミコンダクター営業所または <PCN.Samples@onsemi.com> にお問い合わせください。</p> <p>サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。</p>	
通知種別:	<p>これは、お客様宛の初回製品 / プロセス変更通知 (IPCN) です。IPCN は、近日中に実施される変更に関する事前通知であり、変更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般情報が記載されます。また、暫定的な信頼性認証計画も記載されます。</p> <p>最終的な認定データおよび特性データは最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれます。この IPCN は、変更実施から少なくとも 90 日前に発行される最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に先だって通知されます。ご不明な点がありましたら、<PCN.Support@onsemi.com> にお問い合わせください。</p>	
製品マーキング/変更のトレーサビリティ:	影響を受ける製品は 2020 年 22 週以降の日付コードで識別されます。	
変更カテゴリ:	アセンブリの変更	
変更サブカテゴリ:	材料の変更	
影響を受ける拠点:		
オン・セミコンダクター拠点:	外部製造工場 / 下請業者拠点:	
ON Semiconductor Seremban, Malaysia	なし	
説明および目的:		
この初回変更通知は TSOP6 製品 NTGS3446T1G において 2.0 mils Au ワイヤーから 2.0 mils Cu ワイヤーへの変更認定をお知らせいたします。		
以下の表に比較を示します:		
	変更前の表記	変更後の表記
ボンドワイヤー	2.0mil Gold Wire	2.0mil Cu Wire
今回の変更に伴う製品マーキングの変更はありません。		



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN22945X

発行日 : 31 Oct 2019

認定計画:

デバイス名: NTGS3446T1G

パッケージ: TSOP 6

テスト	仕様	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	2016 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc
HAST*	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
H3TRB*	JESD22-A101	85°C, 85% RH, bias	2016 hrs
UHAIST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	

認定完了予定日 : 26 March 2020

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
NTGS3446T1G	NTGS3446T1G